

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2025-019

希荻微电子集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年11月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年11月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

2025年3月31日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日